

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

엘비세미콘(061970)

반도체/반도체장비

요약
기업현황
재무분석
주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

정원호 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.

엘비세미콘(061970)

반도체 범핑 및 테스트 전문기업, CIS(CMOS Image Sensor) 테스트 물량 본격 시작

기업정보(2021/01/01 기준)

대표자	박노만
설립일자	2000년 02월 10일
상장일자	2011년 01월 31일
기업규모	중견기업
업종분류	발광 다이오드 제조업
주요제품	DDI, PMIC, 테스트

시세정보(2021/10/13 기준)

현재가(원)	11,800
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	5,167
발행주식수	43,784,592
52주 최고가(원)	16,250
52주 최저가(원)	8,890
외국인지분율	1.93%
주요주주	(주)엘비

■ 반도체 후공정, 범핑 및 테스트 전문기업

엘비세미콘은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 범핑 및 테스트 사업을 영위하고 있으며, 2000년 설립 이후, 약 20여 년간 반도체 범핑 및 테스트 기술을 축적한 국내 후공정 기술 선도 기업이다. 웨퍼리스 전문 업체와 공동으로 고객사의 요구에 맞는 고품질의 반도체를 경쟁사 대비 빠르게 개발하고 공급함으로써 고객사로부터 확고한 신뢰를 확보하고 있으며, 축적된 기술력으로 공정기술을 개선하고 차세대 패키지 신기술을 개발 적용함으로써 높은 품질의 제품과 성능을 제공한다.

■ 고객 다변화를 통한 사업영역 확대

COVID-19가 수요 시장에 미치는 영향이 클 것으로 보고 있으며, 반도체 업계의 회복속도 또한 반도체 수요 시장과 지역에 따라 상이할 것으로 예측된다. 중국발 생산 수요 감소 우려는 3월초부터 가동률이 60%까지 상승하면서 빠른 속도로 해소되고 있으며, 글로벌 반도체 업계는 반도체 생산이 중단 없이 지속될 수 있도록 적극적으로 대응하고 있다. 당사는 세계 디스플레이 시장의 점유율을 높여 가고 있는 중화권 시장과 해외 웨퍼리스 업체들의 고객 확보에 노력하고 있으며 후공정 일괄 프로세스 구축을 통해 운영효율화에 힘쓰고 있다.

■ 공정효율화 개선, 신규투자로 CIS, SoC 테스트 물량 본격 시작

당사는 DDI(Display Driver IC)에 편중된 매출구조를 탈피하고자 2020년 9월 CIS, SoC(System on Chip) 테스트 신규투자를 공시하였으며, 향후 공정상의 난이도에서 상대적인 우위 선점을 통해 디스플레이 산업에 대한 민감도를 줄임과 동시에 글로벌 시장경쟁력 강화를 본격화하고 있다. 2021년부터 국내 삼성전자의 CIS 테스트 2차 벤더로 선정되어 스마트폰 카메라 탑재 수 증가와 함께 테스트 물량이 증가하고 있다. 이에 2021년 2분기 영업이익이 2020년 동기 대비 56% 증가하였으며, 하반기에는 애플의 새로운 스마트폰 출시를 앞두고 있어 DDI 동반 매출 증가가 예상된다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	2,757	-	274	10.0	188	6.8	-	-	149.3	349	2,663	11.7	1.5
2019	3,904	41.6	504	12.9	365	9.4	24.5	8.4	152.8	744	3,419	10.5	2.3
2020	4,428	13.4	428	9.7	316	7.1	16.7	6.3	141.7	618	3,977	23.9	3.7

기업경쟁력

후공정 선도기술 확보

■ 범핑

- Au 범프, Solder 범프, Cu Pillar 범프, WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)

■ 프로브 테스트

- DDI, PMIC(Power Management IC), CIS, SoC, 테스트

■ Back-end

- Laminating, Back Grinding, Laser Marking, Foil Mount
- Dicing Saw, Laser Grooving

신사업 다변화 기반 확보

■ CIS, SoC 테스트 신규투자로 인한 가동 본격화

- 고부가가치 제품 양산을 위한 생산 인프라 확보
- 국내 최대 고객사의 CIS, SoC 테스트 2차 벤더로 매출 시현 중

■ 일괄 처리 프로세스로 수익구조 안정성 확보 및 생산 효율성 제고

- 루셈 인수로 다양한 고객 요구 대응 기술 확보
- 가격 경쟁력 확보를 통한 다양한 고객 유치 가능

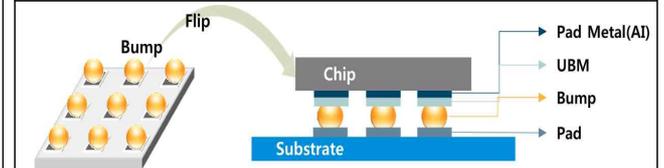
핵심기술 및 취급 품목

핵심기술

- 칩과 기판 간의 전기적 연결을 위한 범프 공정
- 웨이퍼 상태에서 반도체 소자의 양불 판정을 위한 프로브 테스트
- COG(Chip on Glass), COF(Chip on Film) 조립 공정
- WLP(Wafer Level Package) 및 FOWLP(Fan-out WLP) 공정 기술
- CIS, SoC 테스트 기술

주력 제품

플립칩 범프



프로브 테스트 및 조립



ESG 현황

Environment

항목	현황
환경 정보 공개	☑
환경 경영 조직 설치	☑
환경 교육 수준	☑
환경 성과 평가체계 구축	☑
온실가스 배출	☑
에너지, 용수 사용	☑
신재생 에너지	☑

☑ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	☑
여성/기간제 근로자 근무	☑
협력사 지원 프로그램	■
공정거래/반부패 프로그램	☑
소비자 안전 관련 인증	■
정보보호 안전 관련 인증	■
사회공헌 프로그램	☑

☑ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	☑
중장기 배당정책 보유	☑
이사회 내 사외이사 보유	☑
대표·이사회 독립성	☑
감사위원회 운영	■
감사 업무 교육 실시	■
지배구조 정보 공개	☑

☑ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

> (Environment) 당사는 홈페이지에 환경경영 관련 정보를 공개하고 지속적으로 실천하고 있으며, 환경 관련하여 ISO 14001, ISO 45001, IECQ QC 080000, 삼성전자 에코 파트너, 소니 그린 파트너, LG디스플레이 탄소파트너십 등의 인증을 보유하고 있음.
 > (Social) 사회적 책임을 다하기 위한 봉사활동 조직체를 구성하고 있고, 지역 내 차상위 계층 아동 정기 후원, 청소년 범죄 활동예방 후원, 노인요양원 후원, 유망 청년 예술가 활동 후원 등 조화로운 공동체 의식을 형성하는 활동에 적극적으로 참여하고 있음.
 > (Governance) 지배구조 정보 공개를 통해 투명 경영을 위해 노력하고 있고, 주주의결권 행사 지원제도를 실행하여 다양한 의견수렴과 함께 주주총회의 활성화 방안을 제시하고 있으며, 대표·이사회 독립을 통해 윤리경영 준수를 행동원칙으로 삼고 있음.

* 본 ESG현황은 NICE평가정보(주)가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

I. 기업현황

반도체 범핑 및 테스트 종합 솔루션 구축 선도기업, 엘비세미콘

엘비세미콘은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 플립칩 범핑 기술을 이용한 Au 범핑, Solder 범핑, 웨이퍼범핑 테스트 서비스, 반도체 조립사업을 영위하고 있으며, 반도체 제조사나 펌리스 업체로부터 후공정을 일괄로 수주할 수 있는 인프라를 구축하고 있다.

■ 개요

엘비세미콘(이하 동사)은 반도체 범핑 및 테스트 등을 목적으로 2000년 2월에 설립되어 2011년 1월에 코스닥 시장에 상장되었다. 동사의 매출 대부분이 반도체 후공정 수주를 통해 시현 중이며, 주요 사업은 DDI, PMIC 및 CIS 등 반도체 칩 후공정 서비스와 이와 관련된 테스트, Assembly 등으로 구성되어 있다.

■ 사업 현황

동사는 2000년대 초반 국내에서 처음으로 골드 범핑 사업을 시작하면서 지금까지 축적된 기술력으로 공정기술을 개선하고 차세대 패키지 신기술을 개발 적용함으로써 경쟁사 대비 높은 품질과 성능을 구현함과 동시에 원가 면에서도 경쟁우위를 가지고 있다. 동사는 2005년 9월부터 박노만 대표이사 체제로 운영되고 있으며, 2019년 3월 정기 주주총회에서 재선임을 결정하였다. 박노만 대표이사는 경북대학교 전자공학과를 졸업하고 LG반도체와 매그나칩반도체 상무를 역임한 바 있다.

■ 연구개발 이력

동사는 삼성전자를 비롯한 국내외 유수의 반도체, 디스플레이 업체와 긴밀하고 장기적인 협력 관계를 유지하고 있으며, 반도체 범핑 및 테스트 공정기술 개발 및 생산역량 강화를 위해 단기 또는 장기 프로젝트를 구성하여 연구 개발을 진행하고 있다. 동사는 다양한 제품 라인의 공정 효율화와 수율 증가를 위해 2017년부터 2021년까지 11개의 연구 과제를 수행하고 있다.

■ 주요 고객사

세계 최대 패널업체인 LG디스플레이와 삼성디스플레이에 구동칩을 주로 공급하는 엘엑스세미콘과 매그나칩반도체를 주요 고객사로 사업을 영위하고 있으며, 최근 CIS 사업 진출과 함께 삼성전자 CIS 테스트 2차 벤더로 선정되었다. 동사 주력 제품 관련 세계 디스플레이 시장의 점유율을 높여 가고 있는 중화권 시장과 해외 펌리스 업체들의 고객 확보에 노력하고 있으며 후공정 일괄 프로세스 구축을 통해 운영 효율화에 힘쓰고 있다.

■ 보유기술 및 주요 제품 현황

동사는 DDI 중심의 Au 범핑 기술 외에 카메라에 장착되는 이미지 센서와 오토포커싱 IC, PMIC, 메모리 소자, 등을 위한 Solder 범핑과 CU Pillar 범핑 기술을 보유하고 있다. 또한 웨이퍼 상태에서의 칩의 불량률 선별하기 위한 프로브 테스트 기술과 최종 package 형태의 제품을 제조하는 조립공정 기술을 가지고 있어 반도체 후공정(OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 분야의 일괄 공정 기술을 보유하고 있다. 최근에는 CIS, SoC 테스트 생산능력을 확보하여 고객사의 다양한 요구사항에 맞는 제품을 생산하고 있다.

그림 1. 주요 기술 및 제품 현황



*출처: IR자료(2020)

■ 시장 현황 및 특성

세계 DDI 시장은 MarketWatch에 따르면, 2019년 3,975.8백만 달러 규모이며, 이후 연평균 2.3%씩 성장하여 2026년에는 4,702.8백만 달러에 달할 전망이다. COVID-19로 인해 재택근무를 실시하고 비대면 서비스를 제공하는 업체들이 늘어나면서 패널 주문량이 증가하여 올해 DDI 수요는 늘어날 전망이다. Trace Force에 따르면 미국 상무부가 중국의 화웨이를 상대로 한 제재로 발생하는 파운드리 여유분은 제한적일 것으로 내다보고 앞으로의 DDI 가격은 상승할 것이라고 전망하여 동사의 매출 증가가 예상된다.

그림 2. 세계 DDI 시장 규모



*출처: 'Impact of COVID-19 Display Driver IC Market' MarketWatch(2020), NICE평가정보(주) 재구성

■ 경쟁사 현황

동사의 경쟁업체인 네패스, 테스나는 디스플레이용 DDI 제품의 범평사업 외에도 여러 종류의 유사 패키징 사업을 영위하고 있다. DDI가 매출 비중의 가장 많은 부분을 차지하고 있지만, 센서, 전원장치 IC, FOWLP 기술도 보유하고 있다. 동사와 네패스는 유사한 사업을 영위하기 때문에 매출 추이가 비슷한 경향을 보이며, OLED 시장 확대에 의해 동반 성장이 예상된다.

■ 주요 기술개발 인력 현황

동사는 시장 요구사항에 적절히 대응하기 위해 기술개발 능력, 양산 능력, 품질안정화 능력을 사전에 확보하고자 지속적인 연구개발 활동 및 시설 투자를 진행하고 있다. 동사의 CTO 김남석은 서울대학교 금속공학 박사 학위를 보유하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스에 근무한 바 있다.

■ 연구개발 진행 현황

동사의 연구 조직은 연구기획팀, 선행기술팀과 제품개발팀으로 구성되어 있으며 CTO를 중심으로 국책 연구과제와 사내 연구과제를 통해 연구 개발에 주력하고 있다. 전방 산업인 디스플레이 시장에 대한 지나친 의존도에서 벗어나기 위해 IoT, 웨어러블 기기, 자동차 전장산업 등의 성장성 높은 신시장에서의 반도체 소자 후공정 사업에 진출하기 위한 연구개발을 통해 신규 아이템 발굴을 위해 노력하고 있다.

■ 기술사업 분석

동사의 주요 사업 특성상 전방 산업인 디스플레이 패널 업황에 크게 의존하게 되며 사업의 핵심 변수로 작용하게 된다. 반도체 장비 업체의 공장 가동 중단 등 반도체 장비 공급망에 차질이 생기고, 소비심리 위축과 경제활동 제한으로 스마트폰 등 IT 제품 판매 부진이 예상됨에 따라 반도체 산업의 전반적인 부정적 영향이 예상된다. COVID-19가 장기화될 경우, 시장에서 소화하기 힘든 악성재고가 증가해 반도체 가격 하락으로 이어질 수 있으며, 시장의 불확실성이 높아짐에 따라 신규라인 증설에 어려움이 예상된다.

동사가 영위하는 반도체 후공정 산업은 다양한 어플리케이션에 적용될 수 있으며 현재 집중하고 있는 DDI 분야 이외에 새로운 시장을 개척해야 지속적으로 성장할 수 있다. 지금까지 축적된 기술력을 바탕으로 미래의 패키징 기술을 빠르게 확보하고 매출처와의 협업관계 강화로 고객의 요구에 맞는 고품질의 반도체 서비스를 공급함으로써 신뢰를 구축해 나가고 있으며, COVID-19로 인한 불확실성에도 불구하고 반도체 후공정 산업의 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대된다.

최근 동사는 안성 공장 증설을 통해 CIS, SoC 테스트 생산능력을 확보한 상태로, 2021년 초 양산체제 본격 가동으로 인해 꾸준한 매출 증가가 예상된다. 다만, 공급망에 문제가 생길 경우를 대비해 대체 공급자와 계획을 수립하고, 새로운 반도체 수요 시장의 변화를 포착해 민첩한 생산과 공급에 대한 조정과 계획 수립이 필요하다.

프. 재무 분석

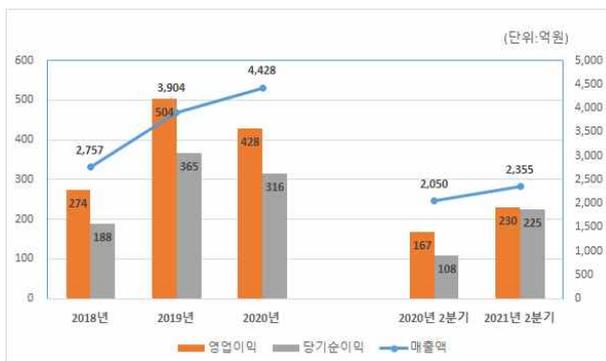
매출 성장세나 총 차입금도 증가 추세

전방 산업에서 비대면 영상 콘텐츠 소비 증가와 대화면에 대한 선호 확대 등으로 디스플레이 구동용 칩 수요가 늘어 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 한편, 외부 자금으로 설비 투자를 지속하면서 총 차입금 규모도 늘어나고 있는 추세다.

■ 비대면 일상화로 IT기기 수요가 증가하여 매출 성장

2020년도에는 COVID-19 대유행으로 비대면 활동 중심의 실내 생활이 크게 늘어나 이와 관련된 온라인시장 성장, 영상 콘텐츠 소비가 늘어나면서 태블릿PC, 노트북 등 IT Device 산업도 성장하여 동사의 매출액은 전년 대비 13.4% 증가한 4,428억 원을 기록하였다.

그림 3. 동사 연간 및 2분기 요약 포괄손익계산서 분석



매출액/영업이익/당기순이익 추이

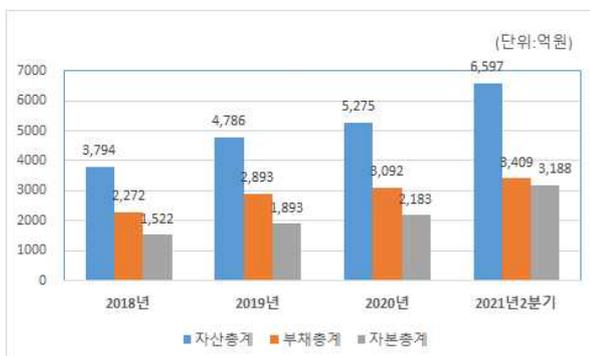


증가율/이익률 추이

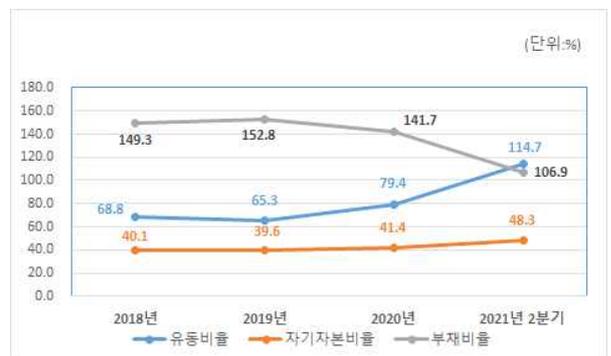
*출처: 동사 사업보고서(2020), 2분기보고서(2021)

*2018년부터 연결재무제표 작성되어 2018년도의 매출액증가율은 표시되지 않음

그림 4. 동사 연간 및 2분기 요약 재무상태표 분석



부채총계/자본총계/자산총계 추이



유동비율/자기자본비율/부채비율 추이

*출처: 동사 사업보고서(2020), 2분기보고서(2021)

■ 매출 성장에도 수익성은 하락

2020년 매출 증가에도 불구하고 재료비의 증가, 가동률 하락으로 영업이익률은 2019년 12.9%에서 2020년 9.7%로, 당기순이익율은 2019년 9.4%에서 2020년 7.1%로 하락하였다. 2020년 결산 시점의 재무안정성 지표는 유동비율 79.4%, 자기자본비율 41.4%, 부채비율 141.7%, 차입금의존도 44.1%를 기록하였는데 대규모 투자 지속으로 총 차입금 규모가 늘어나고 있어 차입금 의존도가 다소 높은 편이다.

■ 2021년 2분기 매출, 안정성 지표 개선

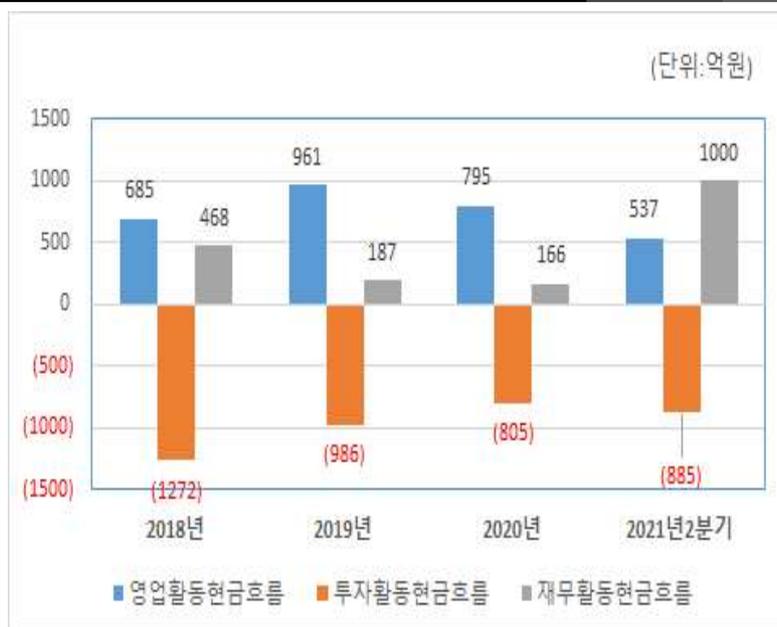
2021년 2분기 동사의 매출액은 전년 동기에 비해 14.9% 증가한 2,355억 원을 기록하였다. 매출 원가율이 소폭 하락하고, 매출 성장으로 판관비 부담이 완화되면서 영업이익률 9.8%, 순이익률 9.6%를 기록하여 수익성은 전년 동기 대비 개선되었다.

주요 재무안정성 지표는 자기자본비율 48.3%, 부채비율 106.9%, 유동비율 114.7%로 2020년 결산시점에 비해 소폭 개선되었는데, 2021년 6월 종속기업 (주)엘비루셈이 코스닥 상장을 위한 유상증자 진행으로 자본총계가 늘어났기 때문이다.

■ 외부자금으로 투자 지속

2020년의 영업활동 현금흐름은 전년도 961억 원에 비해 감소한 795억 원을 기록하였다. 투자활동으로 인한 현금 유출액은 805억 원으로 전년도 986억 원에 비해 감소하였으나, 여전히 영업활동 현금흐름을 뛰어넘고 있어 부족한 자금은 외부자금으로 충당되고 있다.

그림 5. 동사 현금흐름의 변화



*출처: 동사 사업보고서(2020), 2분기보고서(2021)

Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

CIS, SoC 테스트 설비 증설을 통한 신사업 기반의 새로운 도약

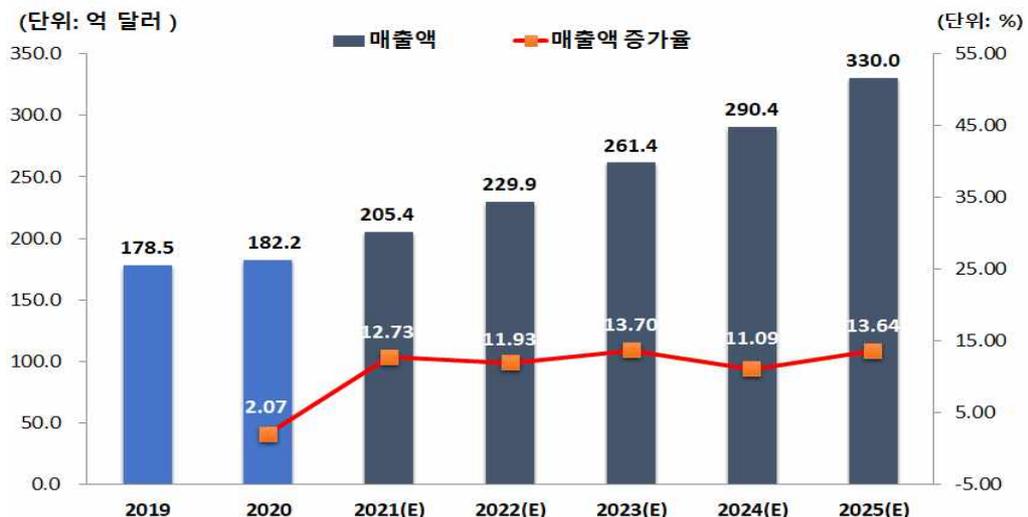
동사는 신규투자를 통해 CIS, SoC 테스트 생산능력을 확보한 상태로, 새로운 사업 포트폴리오 확대를 통해 디스플레이 업황에 대한 민감도를 줄이고 글로벌시장 경쟁력 강화를 본격화하고 있다.

■ 주요 사업 이슈

동사는 DDI에 편중된 매출구조를 탈피하고자 2020년 9월 안성에 위치한 임차 공장에 CIS, SoC 테스트 사업 영위를 위해 581억 원을 투자하였다. 동사는 삼성전자의 CIS 테스트 2차 벤더로 선정되었으며, 스마트폰 1대당 카메라 이미지 센서의 개수가 4개로 늘어나며 매출이 가파르게 증가하고 있다. 이에 2021년 2분기 영업이익이 2020년 동기보다 56% 증가하였으며, 하반기에는 애플의 신제품 스마트폰 출시와 삼성전자의 이미지 센서의 수요 증가로 인해 DDI와 더불어 동반 매출 증가가 예상된다.

COVID-19 대유행이 가속되자 기업, 학교 등 대부분의 공공 활동이 전 세계적으로 중단되어 스마트폰, 자동차 및 광범위한 임베디드를 포함한 CIS 애플리케이션이 급증하였다. 이미지센서 시장의 선두기업인 소니도 2020년 세계 스마트폰 출하량 감소로 매출이 줄어들었지만 2020년 하반기부터 수요가 개선되기 시작하였고, 2020년 말에는 전년도 매출보다 0.3% 증가한 83억 달러를 기록하였다. IC Insights 보고서에 따르면 세계 CIS 시장은 2021년에 강력한 고성장 모멘텀을 되찾아 12.7% 증가한 205억 달러를 기록 할 것으로 예측하고 있고, 향후에는 자율주행차, 산업용 로봇, 스마트시티 등 이미지가 중요한 산업의 핵심 부품으로 활용될 것이며, 인공지능과 결합한 이미지센서가 각광을 받을 것으로 전망된다.

그림 6. 세계 CIS 시장 규모



*출처: A Market Analysis and Forecast for the Optoelectronics, Sensors/Actuators, and Discretes, IC Insights(2021), NICE평가정보(주) 재구성

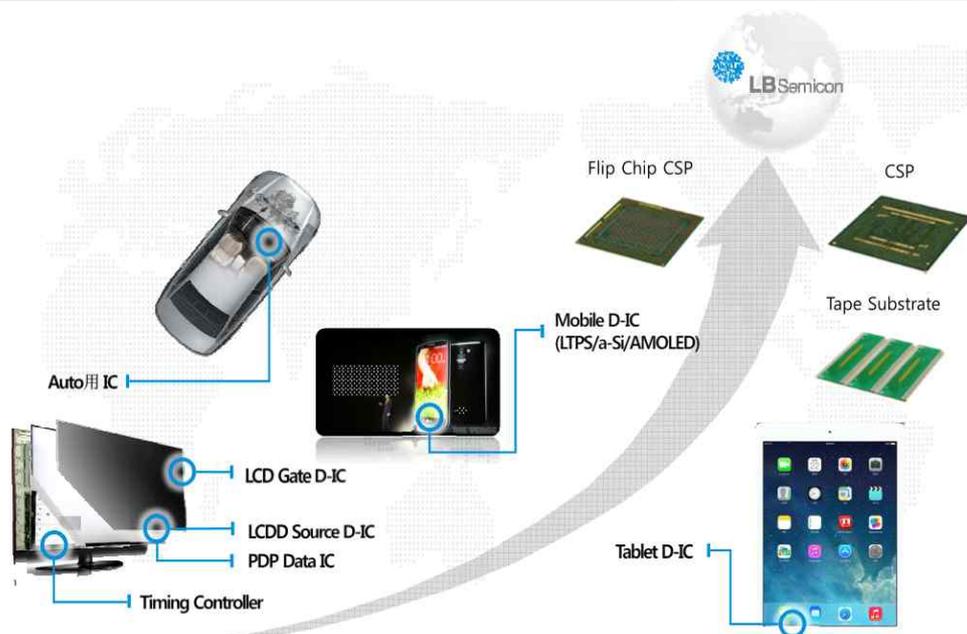
반도체 후공정 기업들의 영세성, 막대한 기술개발 자금, 전문 인력 부족으로 글로벌 기업과의 기술 격차는 점차 확대되고 있다. 따라서 동사가 속한 반도체 패키징 산업에서 업체간 연구개발 능력 및 양산기술의 차별화가 가속화될 것으로 보인다. 부품의 수출과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되며 제품을 빠르고 저렴한 가격에 공급할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다.

■ 기술에 대한 향후 전망

동사는 DDI외에 다양한 어플리케이션으로의 영역 확장을 위해 WLP와 FOWLP 공정의 개발을 진행하고 있다. 기존에는 웨이퍼를 개별 칩단위로 잘라낸 후 와이어 본딩을 활용하여 패키지 조립을 하였으나 WLP는 범핑기술을 활용하여 웨이퍼 상태에서 직접 패키징을 함으로써 반도체 소자의 경박화, 소형화 및 가격 절감에 유리한 패키지 방식이다. 최근 반도체 소자의 입출력 개수가 증가하는 추세를 따라잡기 위해 WLP 기술을 기반으로 하는 FOWLP에 대한 관심이 증가하고 있으며, WLP는 최종 패키지의 크기가 칩 크기에 제한되는 반면 FOWLP는 칩 바깥쪽으로도까지 패키지 영역을 확장시킬 수 있어 보다 많은 수의 패키지 솔더볼 배치가 가능한 첨단 패키지 기술이다.

동사는 최근 CIS, SoC 테스트 신사업 진출을 통해 세계 디스플레이 시장의 점유율을 높여 가고 있는 중화권 시장과 해외 팹리스 업체들의 고객 확보에 노력하고 있으며 후공정 일괄 프로세스 구축을 통해 운영 효율화에 힘쓰고 있다. 지금까지 축적된 기술력을 바탕으로 미래의 패키징 기술을 빠르게 확보하고 매출처와의 협업 관계 강화로 고객의 요구에 맞는 고품질의 반도체 서비스를 공급함으로써 신뢰를 구축해 나가고 있으며, 시스템 산업과 서비스 산업의 고부가 가치화에 대한 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대된다.

그림 7. 엘비세미콘의 어플리케이션 확장 계획



*출처: IR자료(2020)

■ ESG 활동 현황

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. ESG 평가는 기업엔 지속 가능 경영의 동기를 유발하고 투자자에게는 사회적 책임투자에 대한 접근성을 제고하는 지표로 활용될 수 있다. 국내 ESG 평가를 수행하고 있는 기관은 한국기업지배구조원, 서스틴베스트, QESG가 있다.

그림 8. ESG 평가 분류

유형분류	환경(E)	사회(S)	지배구조(G)	금융사지배구조(FG)
기본 평가	기업 분류 민감도별 분류 상 중 하	WICS 기준별 분류** 에너지 소재 ...	자산규모별 분류 2조원 이상 2조원 미만***	상장여부별 분류 상장 금융사 비상장 금융사****
	문항 구성 환경경영 환경성과 이해관계자 대응 3대 대분류	근로자 협력사 및 경쟁사 소비자 지역사회 4대 대분류	주주권리보호 이사회 감사기구 정보공개 (일반) 4대 대분류 (금융사) 7대 대분류	주주권리보호 이사회 최고경영자 보수 위험관리 감사기구 및 내부통제 정보공개

*출처: 한국기업지배구조원 ESG 평가 안내(2021)

산업통상자원부(2021)에 따르면, 현재 평가기관별 ESG 지표의 세부항목이 달라 같은 기업에 대해 등급 편차가 존재하여 평가대상인 기업의 혼란이 가중되고 있는 바, 국내 상황에 적합한 K-ESG 지표를 마련하여 표준화하기 위한 작업이 진행 중이다.

한국기업지배구조원(2021)은 ESG 평가등급을 공개하고 있으며, 각 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구성되어 있다. 이 중 반도체 및 디스플레이에 관한 일부 대기업, 코스닥 상장사의 등급이 제시되어 있다.

표 1. 한국기업지배구조원 반도체, 디스플레이 업체 ESG 등급 현황

기업명	기업코드	ESG 등급	환경	사회	지배구조	평가년도
삼성전자	005930	B	A	A+	C	2021
LG디스플레이	034220	B+	B	A	B+	2021
SK하이닉스	000660	A	A	A+	A	2020
테스나	131970	B	C	B	B	2020
케이씨텍	281820	B	B	B	B	2020
원익IPS	240810	B	C	B+	B+	2020

*출처: 한국기업지배구조원(2021), NICE평가정보(주) 재구성

동사는 지속경영에 관한 품질경영, 윤리경영, 사회책임, 분쟁관련 정책, EHS (Environment, Health, Safety) 전략을 제시하고 사회에 공헌하고자 사회책임 경영방침을 내세우고 있다. 공공이익 실현을 위한 경영 방침과 목표를 공개하여 투명성을 유지하고 있으며, 지속적인 신기술 개발로 향후 잠재적인 시장수요를 선점하고자 노력하고 있다.

동사는 환경인증과 관련하여 삼성전자 에코파트너 인증을 보유하고 있으며, 삼성전자는 이 제도를 통해 거래 대상업체를 선별하고 있다. 협력사 환경 유해물질을 통합 관리하는 시스템으로 부품 구매단계부터 제품에 유해물질이 포함되지 않도록 생산공정의 환경영향을 평가하고 있다. 또한, 소니의 그린 파트너 인증은 ‘부품 및 재료에 포함된 환경 관련 물질 규정’을 명시하고 있으며, 즉시 금지되거나 감소될 환경 물질에 대해 규정을 준수하는 제도로 환경보전에 대한 책임을 다하기 위해 힘쓰고 있다. 주 고객사인 LG디스플레이와 탄소파트너십을 체결하여 인증 심사를 통해 협력사의 기후변화에 따른 대응능력을 향상시킬 수 있도록 지원하는 녹색동반성장 제도를 실천하고 있다.

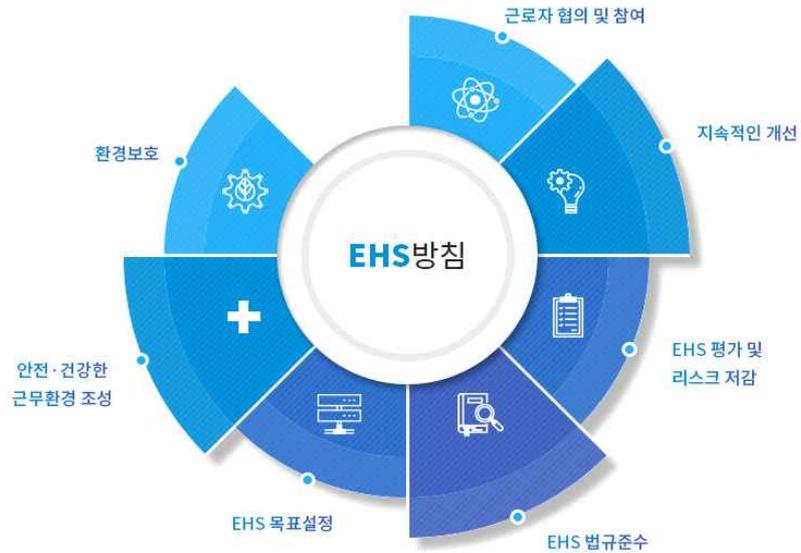
그림 9. 환경 관련 인증 현황



*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

동사는 환경 및 인간존중의 경영으로 EHS 방침을 규정하고, 지속적인 개선과 실천을 통해 모든 임직원에게 안전하고 쾌적한 사업장을 제공하고 있다. 자원 및 에너지 절약을 통하여 오염물질 배출을 최소화하고, 위험요소를 근원적으로 제거하여 안전하고 건강한 근무환경을 조성하고 있다. 또한 EHS 법규, 규정, 이해관계자의 요구사항을 준수하고, 성과를 유지하고 개선하기 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 단방향 경영방침 제시가 아닌 EHS 활동에 대해 상호 신뢰와 협력을 토대로 근로자와 협의하고 참여를 보장하고 있다.

그림 10. EHS 경영 방침



*출처: 동사 홈페이지(2021)

동사는 인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하고 ‘고객을 위한 가치창조’와 ‘인간존중의 경영’의 경영이념 아래 ‘화합과 인간중시’ 경영체제를 구축하고 있다. 지배구조 정보 공개를 통해 경영의 건전성을 유지하고, 합리적인 투자, 원가절감, 생산성 향상 등을 통해 장기적이고 안정적으로 주주의 이익을 보호하고 있다. 또한, 모든 사람들이 행복할 수 있는 더 나은 세상을 만들기 위한 노력으로 지속적인 사회 공헌 활동을 통해 조화로운 공동체 의식을 형성하는 CSE(Creating Social Ecosystem)를 이행하고 사회적 책임경영에 대한 모범 답안을 제시하고 있다.

그림 11. 사회 공헌 활동

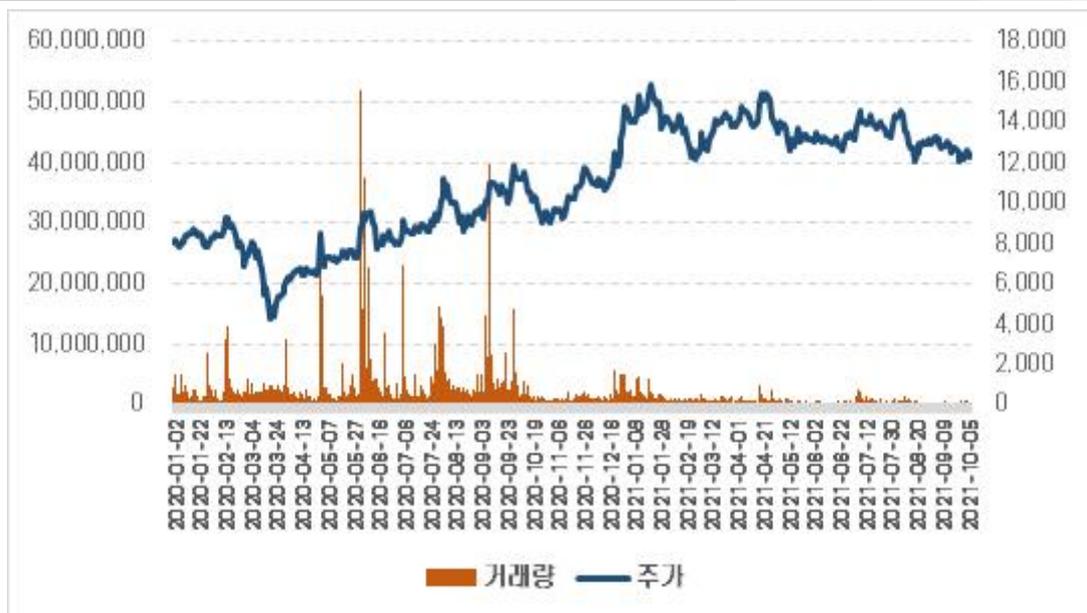


*출처: 동사 홈페이지(2021)

■ 증권사 투자 의견

작성기관	투자 의견	목표주가	작성일
한화 투자증권	Not Rated	-	2021-10-01
	<ul style="list-style-type: none"> • 테스트 사업 비중 확대로 포트폴리오 다변화 • 후공정 아웃소싱 물량 확대 가시화 		
SK증권	Not Rated	-	2021-09-29
	<ul style="list-style-type: none"> • 955 억원 규모의 비메모리 테스트 신규시설 투자 공시 • 이번 투자를 통한 연간 테스트 매출 기여는 200~250 억 원 		
하나 금융투자	Not Rated	-	2021-08-02
	<ul style="list-style-type: none"> • 2분기에 DDI와 카메라 이미지 센서가 상대적으로 견조 • 삼성전자 비메모리의 절치부심이 하반기 기대 요인 		
현대차 투자증권	BUY	18,000	2021-04-30
	<ul style="list-style-type: none"> • CIS와 AP 테스트 사업이 본격적으로 실적 성장에 기여할 것으로 예상 • 양호한 실적 전망 및 올해 하반기로 가면서 실적이 성장하는 전망이 여전히 유효 		

■ 시장 정보(주가 및 거래량)



*출처: Kisvalue(2021.10.)